

## 内 容 简 介

本书综合了近年来国内外混合集成电路的已有成就，并结合作者多年来从事该技术的实践经验撰写而成。全书共分十二章。内容包括厚薄膜混合集成电路的材料、元器件、成膜技术、调整技术、图形设计、电路制造、封装技术、可靠性分析及电路应用等方面。

本书可供研制和应用微型集成电路的科技人员，工科大专院校电子类专业专业的师生及电子系统的专业干部阅读参考。

## 厚薄膜混合集成电路

——设计、制造和应用

郑福元 周立飞 虎轩东 编著

责任编辑 魏 玲

科学出版社出版

北京朝阳门内大街137号

中国科学院印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经营

\*

1984年4月第 一 版 开本：787×1092 1/16

1984年4月第一次印刷 印张：20 1/2

印数：0001—5,600 字数：474,000

统一书号：15031·563

本社书号：3513·15-7

定价：3.20 元